

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Use of solder resist ink of too low viscosity, misalignment of printing screen, a printing screen with dirty back or a broken printing screen causes the defect. In case of photo solder resist, the deteriorated developer or the clogged developer nozzle may also cause the defect. (Solder resist application process)

2-1-1-14 部分的 SR 詰り／局部堵塞 SR / Via hole clogged partially with solder resist

【特徴】 数穴以下の部分的 S R 穴詰まり

【特征】 个别的孔堵塞 SR。

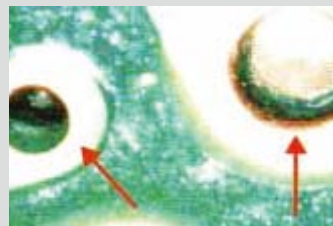
【Characteristics】 Less than several holes are clogged with solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】 印刷版の部分的乳剂剥がれ、版裏への異物付着、印刷後乾燥までの取扱いによる衝撃などにより出来たもの。非スル、バイアホール、スルーホールのいずれにも出来る可能性あり（S R 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】 网版局部的乳剂层脱落、网版的背面附着杂物、印刷后烘干前的处理受到冲击等所造成的，非通孔、导通孔、元件孔任何一种孔都有可能发生（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Such a clog is caused by partial stripping of printing screen emulsion, a foreign object on the back of printing screen and a shock given to a board during handling from printing to curing. The defect can happen to all types of hole of non-plated-, via- and plated-through holes. (Solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率 ×20

【Comments】
Magnification: ×20



【コメント】
顕微鏡倍率×30

【注釋】
显微镜倍率 ×30

【Comments】
Magnification: ×30

2-1-1-15 部分的 SR 色むら／SR 的颜色局部不均匀 / Local uneven colour of solder resist colour

【特徴】 S R の厚さの差により、部分的に色むらに見える状態の欠陥

【特征】 由于 SR 厚度有差异，出现局部的颜色不均匀的缺陷。

【Characteristics】 Uneven solder resist thickness causes local uneven colour of solder resist.



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×